

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年9月9日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	长城证券、混沌投资、德邦证券、国海证券、中信建投、交银施罗德、凯石基金、华能信托、中信建投资本、浦银安盛、明达资产、中庸资产、金鼎资本、紫时基金、华鑫证券、国泰君安证券、APS、上海道昆私募、炬诚资产、方圆金鼎投资、紫时私募基金、光证资管、西部利得基金、申万菱信基金
活动时间	2024年9月3日、9月5日、9月6日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度的经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司的车规产品目前进展如何？ 答：车规产品目前公司的 SLC NAND Flash 及 NOR Flash 均有产品通过 AEC-Q100 测试，并已实现车规级产品销售。公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品，扩大车规级产品线丰富度。 2、公司如何看待存储行业的周期性对公司带来的影响？ 答：周期性是半导体行业的常态，存储芯片行业作为强周期的行业，行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进，元宇宙、自动驾驶、人工智能等数据密集型应用技术不断涌现，势必将引发数据存储的浪潮。

	<p>随着未来市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，以及国产替代的巨大需求，从全球范围来看，中国市场仍有较大机会。</p> <p>3、公司对于非存储线的布局是出于什么样的考虑和规划？ 答：公司希望从多方面进行产业链上下游的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在存储板块内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，提升营收体量，分摊周期风险。</p> <p>4、公司在 DRAM 产品上有哪些布局？ 答：公司的 DRAM 产品主要分成两大类，一类是标准 DDR3，另外一部分是低功耗 LPDDR1、LPDDR2，以及 LPDDR4X。公司在 DRAM 产品方面会不断扩充产品品类，不断丰富 DRAM 自研产品组合，提高产品市场竞争力。</p> <p>5、能否更新一下公司各条产品线的研发进度？ 答：SLC NAND Flash 产品方面，公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发，不断扩充产品线。公司先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发工作已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。 NOR Flash 产品方面，公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。 DRAM 产品方面，公司将不断丰富 DRAM 自研产品组合，提高产品市场竞争力。 车规产品目前公司的 SLC NAND Flash 及 NOR Flash 均有产品通过 AEC-Q100 测试，公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品，扩大车规级产品线丰富度。 此外，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，组建了一只经验丰富的研发团队从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的设计研发，目前产品尚在研发阶段。</p>
日期	2024 年 9 月 9 日